

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位 及人员	中信证券、金鹰基金、宏利基金、摩根士丹利基金、华安基金、社保基金、浙商证券、中邮证券、国信证券、华福证券研究所、创金合信基金、浙江龙航资产管理、中再资产、华富基金、前海开源基金、上海晨燕资管、九泰基金、申万菱信平安基金、永赢基金、上海呈瑞投资、长江证券、平安基金、中泰证券、光大保德信基金、中庚基金、农银汇理基金、北京新荣拓展投资、东方阿尔法基金、国元证券、中银基金、东北证券、安信基金、兴证证券、合众资管、国寿安保基金、北京涇谷私募基金、易方达基金、太平资管、上海明河投资、尚诚资管、国泰海通、国元证券、睿郡资管、长江证券、申万宏源、长城证券、甬兴证券、天弘基金、新活力资本、万向创投、浙江壁虎投资、狐尾松资产、全天候私募、国投瑞银基金、宝盈基金、九泰基金
时间	2025 年 10 月 26 日
地点	线上会议 及 现场交流
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	一、公司业绩与存储芯片产业的关系 公司的硅零部件产品，由大直径硅材料加工而成，其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，是需要定期更换的核心耗材；其更换频率与存储芯片制造产线的开工率和刻蚀应用强度相关——开工率越高，刻蚀次数越多、强度越大，对硅零部件的消耗就越多。 当前，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局； 中国芯片制造国产化进程进入“深水区”，供应链安全需求迫切，国产设备厂商技术水平不断提升并追赶世界先进水平，产品持续迭代升级；

	某些国家对跨国公司设立于中国大陆的存储芯片制造厂加以反复无常的技术钳制和产能限制，迫使后者将目光投向中国本土供应链。 综上，市场机会窗口敞开，公司的业绩弹性有望实现。 二、存储市场变化与未来趋势研判 展望2025年第四季度以及2026年，公司认为当前半导体产业正在“换挡变速”：今年以来，全球科技巨头对算力中心的资本开支金额，已经从此前单季度300-400亿美元，大幅增加至单季度500-800亿美元的历史新高，并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求，因此存储芯片产能出现结构性短缺；中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局；此外，消费者端侧应用创新正在加速，有望为半导体周期上行带来最根本且持久的市场驱动力。 公司大直径硅材料的制成品硅零部件，主要应用于存储芯片制造厂的刻蚀环节，开工率越高，使用量越大。公司认为，半导体产业周期上行有望带来更多市场需求。公司是上游材料及零部件供应商，如果下游终端存储芯片制造厂的开工率提升乃至资本开支增加带来新的需求，预计需要约1-2个季度传导到公司。 三、公司业绩的趋势性变化 分析2025年前三季度经营情况，公司管理层关注三个趋势： 第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率仍然保持在60个点以上，继续保持着领先的盈利能力，本季度公司的毛利率继续提升； 第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重持续超过大直径硅材料，公司第二增长曲线进一步强化。公司已经从一家原材料公司逐步转变为一家植根中国本土市场的“材料+零部件”公司； 第三，以上两项业务的融合，“自产材料+零部件”，有望改变公司业绩“周期性”的特点，“成长性”将日益明显。 四、硅片业务的行业环境变化 公司注意到，半导体硅片产业在因时而变。在8吋轻掺抛光硅片领域，具备全
--	--

	球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，正在将更多产能调配至12吋轻掺抛光硅片，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利能力。 考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，日本厂商的动向有望扩大国产化空间。公司作为国内少数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。 公司已在第三季度投入资源，针对下游评估的实际需求，小幅增加硅片生产量。 五、硅零部件业务的扩产进度 土地、厂房、设备等生产要素的整備只是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续健康发展。 因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力保持良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。 前三季度，公司的硅零部件产能扩张方针“稳”字当头，产品结构改善，成本有所下降，毛利率稳中有升，取得良好成效。 六、公司未来计划 公司将稳健扩产并提升硅零部件产品收入；公司还计划抓住中国本土硅片市场供求关系的局部变化，满足下游客户的国产化需求；公司大直径硅材料产能全球领先，开工率提升空间较大，已经为新的外部需求做好准备，并为硅零部件业务的长远发展奠定坚实基础。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，提高了公司向金融机构申请授信的额度，从3.5亿元提高至8亿元。 综上，公司管理层已为接下来的潜在市场变化做好充分的产能和资金准备，
--	---

	将通过更高的资金使用效率来加强股东回报。 纵观国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。公司将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。
附件清单	无
日期	2025 年 10 月 27 日